****

|  |  |
| --- | --- |
| **Reader enquiries:** | **Press contact:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com [www.congatec.com](http://www.congatec.com)  | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |

******

***The pinout of the new COM-HPC standard***

*Text and photograph available at:* [*https://www.congatec.com/en/congatec/press-releases.html*](https://www.congatec.com/en/congatec/press-releases.html)

Press release

진전을 보이고 있는 PICMG COM-HPC 위원회

**COM-HPC 핀 배치 승인 완료**

**Deggendorf, Germany, 13 November 2019 \* \* \*** congatec(콩가텍)은 PICMG COM-HPC 기술 분과 위원회에서 이 새로운 고성능 COM(Computer-on-Module) 사양의 핀 배치를 승인했다고 발표했다. 새로운 COM-HPC 표준은 이제 2020년 상반기로 예정된 버전 1.0 사양의 비준을 위한 최종 단계에 접어들고 있다. COM-HPC 작업 그룹에서 활동 중인 COM(Computer-on-Module) 제조업체 및 캐리어 보드 설계업체는 이제 내년에 Intel®과 AMD의 새로운 고급 임베디드 프로세서 세대 출시에 맞춰 시장에 출시할 수 있을 것이라는 기대를 가지고 사전 승인된 이 데이터를 기반으로 최초의 에지 컴퓨팅 설계에 착수할 수 있다.

PICMG의 회장인 Jessica Isquith는 COM-HPC 사양의 진전 상황에 흡족해 하고 있다. “우리 PICMG는 현재 임베디드와 에지 컴퓨팅 업계에 매우 중요한 차세대 COM(Computer-On-Module) 표준을 마련하고 있다. 물리적 풋프린트 다음으로 핀 배치는 가장 핵심적인 단계이다. COM-HPC 기술 분과 위원회가 Intel과 같은 반도체 제조업체를 비롯한 모든 주요 시장 참여업체와 함께 논의를 거쳤기 때문에 이렇게 빨리 핀 배치에 대한 승인을 완료할 수 있었으며, 이로 인해 이 표준은 미래의 프로세서 세대에 최적의 표준이 될 것이다.”

위원회 위원장인 Christian Eder는 다음 고급 임베디드 프로세서가 시장에 출시되기 전에 이 사양이 공식적인 비준을 받을 수 있을 것이라고 확신하고 있다. “새로운 COM(Computer-on-Module) 사양은 많은 이해관계자가 관여하고 있는 복잡한 일이다. 하지만 우리는 공식적으로 지난 2018년 10월에 이 일에 착수했으며 예정대로 다음 고급 임베디드 프로세서 세대 출시에 맞춰 새로운 COM-HPC 모듈과 캐리어 보드 및 솔루션 플랫폼을 출시할 것이다. 이러한 출시 제품으로 기존 PICMG COM Express 모듈 표준이 Headless 에지 서버와 더 많은 기능을 제공하는 에지 클라이언트 솔루션의 방향으로 확장될 것이다.”

핀 배치의 채택으로 모든 위원회 구성원은 이제 표준화된 COM-HPC 모듈에서 최대 8개의 DIMM 소켓 및 고속 프로세서(200와트 이상)는 물론 최대 100GbE 및 PCle Gen 4.0/Gen 5.0을 지원하는 인터페이스를 제공하고 표준에 맞는 캐리어 보드를 설계하기 위한 탄탄한 작업 기반을 갖추게 되었다.

PICMG COM-HPC 위원회의 구성원은 University of Bielefeld & Adlink, Advantech, Amphenol, AMI, congatec(콩가텍), Elma Electronic, Emerson Machine Automation Solutions, ept, Fastwel, GE Automation, HEITEC, Intel, Kontron, MEN, MSC Technologies, N.A.T., Samtec, SECO, TE Connectivity, Trenz Electronic, VersaLogic 등이 있다. Adlink, congatec(콩가텍) 및 Kontron은 이 위원회의 후원자이기도 하다. congatec(콩가텍)의 마케팅 디렉터인 Christian Eder는 COM-HPC 위원회의 위원장이다. 그는 현 COM Express 표준을 개발하는 과정에서 초안 편집자로 참여한 바 있다. Kontron의 Stefan Milnor와 Samtec의 Dylan Lang이 PICMG COM-HPC 위원회의 편집자와 총무로 각각 Christian Eder를 지원하고 있다.

새로운 COM-HPC COM(Computer-on-Module) 표준 및 핀 배치에 대한 자세한 내용은 <https://www.congatec.com/COM-HPC>에서 확인할 수 있다.

**About congatec**

congatec is a rapidly growing technology company focusing on embedded computing products. The high-performance computer modules are used in a wide range of applications and devices in industrial automation, medical technology, transportation, telecommunications and many other verticals. congatec is the global market leader in the computer-on-modules segment with an excellent customer base from start-ups to international blue chip companies. Founded in 2004 and headquartered in Deggendorf, Germany, the company reached sales of 133 million US dollars in 2018. More information is available on our website at [www.congatec.com](http://www.congatec.com) or via [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/455449), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) and [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel is a registered trademark of Intel Corporation in the U.S. and other countries.*